附表一：系爭專利請求項 1 與被證 1 之比對：

系爭專利請求項 1 技術特徵	被證 1 揭露處與揭露內容	是否 揭露
(a)一種移除失效型無線射頻辨識(RFID)電子標籤結構，包括：	被證 1[摘要]揭露：一種 RFID 標籤，……標籤可在自物體表面移除時被破壞("The label may include RFID components……break apart the tamper track when the label is tampered, for example, by removal from an object.")。故被證 1 爲一種移除失效型無線射頻辨識(RFID)電子標籤結構。	是
(b)一表面層，具有一第一表面及一第二表面，且互爲相對面；一印刷天線，位於該表面層的第一表面上；一無線射頻晶片(RFIC)，位於該表面層的第一表面上，並電氣連接至該印刷天線，以形成一無線射頻辨識(RFID)裝置；一接著層，係覆蓋該表面層的第一表面、該印刷天線及該無線射頻晶片	被證 1 圖 7A、7B 揭露： 一 RFID 層 101（相當於表面層，因爲最外層 104 並非必要，請參 Col. 4, lines 51-52），其當然具有互爲相對面之一第一表面及一第二表面； 一印刷天線 102，位於該表面層 101 的第一表面上； 一無線射頻晶片（RFIC）402，位於該表面層 101 的第一表面上，並電氣連接至該印刷天線 102，以形成一無線射頻辨識(RFID)裝置； 一接著層 103，係覆蓋該表面層 101 的第一表面、該印刷天線 102 及該無線射頻晶片 402（第 5 欄第 33-34 行、圖 7B：在有些沒有接著強度調整層 105 通過之區域，接著層 103 直接與印刷天線 102 及表面層 101 接著；圖 7A 則顯示接著層 103 亦直接與 RFIC 402 接著）。	是
(c)以及一離型層		否

(d)其中該接著層的接著強度滿足以下條件的其中之二：大於或等於該表面層的材料強度；大於或等於該印刷天線的材料強度；大於或等於該印刷天線對該表面層的附著強度；大於或等於該無線射頻晶片對該表面層的附著強度；大於或等於該無線射頻晶片對該印刷天線的附著強度。	● 第 1 欄第 46-49 行：「一可破壞之導電線路（即「天線」）可被包夾於 RFID 層（101，相當於表面層）與接著層之間；於標籤被故意損壞時，會造成該可破壞之導電線路之破斷。(A destructible conducting path may be sandwiched between the RFID layer and the adhesive layer. The destructible conducting path should be disrupted when the label is tampered.)」 ● 第 5 欄第 58-61 行：「通常，但並非絕對必要去使用接著強度調整層 105 以降低兩層間的接著強度...(Usually, but not necessarily, the adhesion modifying coating 105 reduces the adhesion of two layers...)」 由上可見被證 1 亦揭露在沒有接著強度調整層 **105** 之情況下，包夾於表面層與接著層間的印刷天線，於標籤撕除時會破斷之態樣。因此，至少已揭露系爭專利接著層的接著強度滿足以下條件的其中之一：大於或等於該印刷天線的材料強度；大於或等於該印刷天線對該表面層的附著強度。	是

附表二：系爭專利請求項 1 與被證 2 之比對

系爭專利請求項 1 技術特徵	被證 2 揭露處與揭露內容	是否 揭露
(a)一種移除失效型無線射頻辨識電子標籤結構	被證 2 圖 1、第 2 欄第 13-24 行揭露：「防僞標籤材質係經設計處理成當其自基板上移除時能自我毀壞…（"Tamper evident label materials are engineered to self-destruct when removed from a substrate….）	是
(b)一表面層，具有一第一表面及一第二表面，且互爲相對面；一印刷天線，位於該表面層的第一表面上；一無線射頻晶片(RFIC)，位於該表面層的第一表面上，並電氣連接至該印刷天線，以形成一無線射頻辨識(RFID)裝置；一接著層，係覆蓋該表面層的第一表面、該印刷天線及該無線射頻晶片	●被證 2 圖 1、第 2 欄第 43-49 行揭露一具有表面層 M1、接著層 1、無線射頻晶片 2、離型層、之防偽標籤，當離型層被撕下後，標籤被其貼附至一基板 3（"This label with adhesive 1 and release liner contains an embedded passive RFID transponder tag inserted… After printed, the label is removed from the release liner…; the RF transponder remains attached to the adhesive 1 and is applied with the label to a substrate 3."）	是
	●被證 2 圖 5、第 3 欄第 37-40 行揭露：一無線射頻晶片(RFID transponder)2 電氣連接至該印刷天線("RF transponders 2 are typically manufactured… designed to accept the printed antenna 5 （印刷天線 5）and mounted integrated circuit chip 6.") ●被證 2 圖 1-4 均揭露當離型層被	是

	撕除後，無線射頻晶片 2 被接著層 1 黏接至表面層（M1/M2/M3）與物體（substrate）3 之間，而圖 5 揭露天線 5 與無線射頻晶片 2（含有一 circuit chip 5）電氣互連。故天線 5 係位於與無線射頻晶片 2 之同一層，故接著層 1 係覆蓋該表面層 M1/M2/M3 的第一表面、該天線 5 及該無線射頻晶片 2。	
ⓒ以及一離型層	被證 2 於第 2 欄第 43-49 行揭露一具有離型層之防偽標籤（"This label with adhesive 1 and release liner.）	是
ⓓ其中該接著層的接著強度滿足以下條件的其中之一：大於或等於該表面層的材料強度；大於或等於該印刷天線的材料強度；大於或等於該印刷天線對該表面層的附著強度；大於或等於該無線射頻晶片對該表面層的附著強度；大於或等於該無線射頻晶片對該印刷天線的附著強度	●被證 2 圖 1 第 2 欄第 13-24 行揭露：「當其從一表面剝離時，其永久性的接著力較該標籤表面層為強（"Tamper evident label materials are engineered to self-destruct when removed from a substrate…. The 7610 product uses a fragile cast vinyl face with very low tensile and tear resistance designed to crack and break when peeled off of a surface because the permanent adhesive bond is stronger than the label face."）」 因此，被證 2 揭露系爭專利(d)技術特徵之該接著層的接著強度大於或等於該表面層的材料強度。	是

	● 第 2 欄 19-25 行揭露選擇一種黏著層，其黏著強度(permanent adhesive bond)大於標籤表面材料(label face)的抗拉伸和剪切力(tensile and tear resistance)，以實現「移除失效(crack and break)」的效果。	

附表三：系爭專利請求項 1 與被證 3 之比對

系爭專利請求項 1 技術特徵	被證 3 揭露處與揭露內容	是否揭露
(a)一種移除失效型無線射頻辨識電子標籤結構	● 被證 3[Background of the Invention]揭露本發明係關於 RFID 標籤。 ● 第 8 欄第 5-7 行揭露：該防偽天線回路係設計成可被破壞（The tamper tracks are designed to be destructible..."）	是
(b)一表面層，具有一第一表面及一第二表面，且互為相對面；一印刷天線，位於該表面層的第一表面上；一無線射頻晶片(RFIC)，位於該表面層的第一表面上，並電氣連接至該印刷天線，以形成一無線射頻辨識(RFID)裝置；一接著層，係覆蓋該表面層的第一表面、該印刷天線及該無線射頻晶片	被證 3 圖 2A、2B 實施例、第 8 欄第 1-7 行及圖 7 實施例均揭露：一印刷天線 102，位於該表面層 101 的第一表面上；一無線射頻晶片 402，位於該表面層 101 的第一表面上，並電氣連接至該印刷天線 102，以形成一無線射頻辨識(RFID)裝置，且該防偽天線回路係設計成可被破壞。("The RFID components 402 are on the underside of the layer 101.... in the design of Fig. 7, both the RFID memory chip 402 and the tamper track 102 are on the underside of the layer 101. The tamper tracks are	是

	designed to be destructible..."）由此可見，被證 3 的層 101 相當於系爭專利表面層 10。	
	被證 3 圖 2A、2B 實施例揭露接著層 103 覆蓋該表面層 101 的第一表面、該印刷天線 102 及該無線射頻晶片。請參第 5 欄 54-61 行：「圖 2A 揭露標籤 100 尚未自表面移除...圖 2B 揭露標籤 100 之部分已自表面移除...當標籤 100 被移除時，一部份之天線 102 殘留於表面層 101，另一部份之天線則殘留在接著層 103（In Fig. 2A the label 100 is shown before removal...In Fig. 2B the label 100 has been partially removed... As the label 100 is removed, portions of the tamper tracks 102 remain with the top layer 101, and complementary portions of the tamper tracks 102 remain with the adhesive layer 103.）」（請注意此實施例中不含接著強度調整層） 第 6 欄 7-8 行：「天線 102 電氣連接至具有 RFID 之表面層 101（temper track 102 are electrically connected to the layer 101 which includes RFID.）」 可見已揭露接著層 103 係覆蓋該表面層 101 的第一表面、該印刷天線 102 及 RFID。	
ⓒ以及一離型層	被證 3 圖 10B 及第 12 欄第 43-46 行揭露一離型層 1002 位於該接著層 906 上（內文爲："When the release liner layer 1002 is removed from adhesive layer 906, a stress is applied to the adhesion modifying coating layer 1001, the tamper	是

	track layer 905 and adhesive layer 906.")。	
(d)其中該接著層的接著強度滿足以下條件的其中之一：大於或等於該表面層的材料強度；大於或等於該印刷天線的材料強度；大於或等於該印刷天線對該表面層的附著強度；大於或等於該無線射頻晶片對該表面層的附著強度；大於或等於該無線射頻晶片對該印刷天線的附著強度	被證3圖2A、2B實施例揭露接著層103覆蓋該表面層101的第一表面、該印刷天線102及該無線射頻晶片。 請參第5欄54-61行：「圖2A揭露標籤100尚未自表面移除...圖2B揭露標籤100之部分已自表面移除...當標籤**100**被移除時，一部份之天線**102**殘留於表面層**101**，另一部份之天線則殘留在接著層**103**（In Fig. 2A the label 100 is shown before removal...In Fig. 2B the label 100 has been partially removed... As the label 100 is removed, portions of the tamper tracks 102 remain with the top layer 101, and complementary portions of the tamper tracks 102 remain with the adhesive layer 103.）」（請注意此實施例中不含接著強度調整層） 故已揭露：接著層的接著強度大於或等於該印刷天線的材料強度，或，大於或等於該印刷天線對該表面層的附著強度。	是
	被證3圖7A、7B揭露：接著層之接著強度藉由一調整層而可調整爲使印刷天線102「易於被破壞」，因此接著層滿足系爭專利(d)技術特徵的其中之一，亦即：接著層的接著強度大於或等於該印刷天線的材料強度，或，大於或等於該印刷天線對該表面層的附著強度，方能使天線易於破壞。	
	被證3其他揭露尚有第8欄第14-16行及26-30行：「一接著強度調整披覆層可被加入（至接著層中），以強化天線	

是

	102 的可破壞性（"An adhesion modifying coating may be included...to enhance destructibility of the tamper tracks 102."）。」「此一接著強度調整披覆層的存在，調節了標示顏色層到接著層 103 的接著強度，因此，當標籤 100 自其所貼附之表面移除時，標示顏色層將破裂。標示顏色區可以附著至接著層 103 而其他有顏色的互補區域可附著至表面層（RFID 層）101（"The presence of the adhesion-modifying layer modifies the adhesion of the colored layer to the adhesive layer 103 such that when the label 100 is removed from a surface to which it has been applied, the colored layer breaks up. Areas of color may adhere to the adhesive layer 103 and other complementary areas of color may adhere to the RFID layer 101."）。	